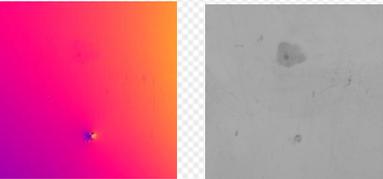
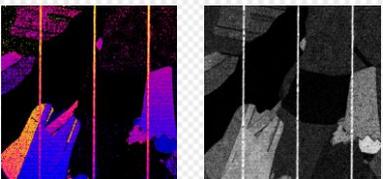
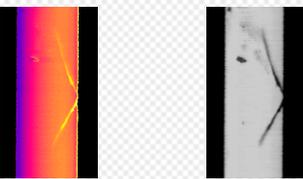


### 量産ラインでの全数検査に最適!

**Rapid3D** シリーズは対象物表面をレーザー光で走査し、連続的に高さを計測する測定装置です。対象物の表面状態や色に影響され難く、ゴム製品から金属面までの広範囲なワーク表面に対応できる高分解能かつ高速な検査装置です。電子部品の全数検査や、連続成形品、フィルム検査などに利用されています。また、大面積ワークの全面検査や透明フィルム検査用にカスタマイズした検査システムなどにも実績がございます。

光切断法では難しい「形状」と「12bit 白黒画像」の同時計測機能により、傷や腐食なども検出することができます。また、それぞれのデータを総合的に解析することで不良項目特定や誤判定を防ぐことができます。

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>レーザーイメージングヘッド</b></p>  <p>凹凸画像<br/>精密プレス板</p> <p>汚れ画像<br/>精密プレス板</p> | <p><b>2.5D</b></p> <p>測定幅 40 mm<br/>測定ピッチ 30 μm<br/>測定深度 ±650 μm<br/>走査速度 9,000 line/s<br/><b>凹凸・汚れ分離可能</b></p> |    |
| <p><b>高分解能ヘッド</b></p>  <p>高さ画像<br/>太陽電池パネル</p> <p>白黒画像<br/>太陽電池パネル</p>    | <p><b>3D</b></p> <p>測定幅 20 mm<br/>測定ピッチ 5 μm<br/>測定深度 ±100 μm<br/>走査速度 1,750 line/s<br/>再現性 ±1.0 μm</p>         |   |
| <p><b>高速ヘッド</b></p>  <p>高さ画像<br/>光沢金属箔</p> <p>白黒画像<br/>光沢金属箔</p>         | <p><b>3D</b></p> <p>測定幅 18 mm<br/>測定ピッチ 20 μm<br/>測定深度 ±200 μm<br/>走査速度 10,600 line/s<br/>再現性 ±1.5 μm</p>       |  |
| <p><b>小型ヘッド</b></p>  <p>高さ画像<br/>スマートフォン</p> <p>白黒画像<br/>ガラス端面</p>       | <p><b>3D</b></p> <p>測定幅 4 mm<br/>測定ピッチ 2.5 μm<br/>測定深度 ±250 μm<br/>走査速度 4,000 line/s<br/>再現性 ±1.5 μm</p>        |  |

## レーザーイメージングヘッド・小型ヘッド併用で

## 効率的で確実な大面積の高速検査も可能

■ 精密プレス板 打痕・汚れ検査

ハイブリット検査 効率的で確実な高速検査を実現

150×150mm エリア検査タクト(凹凸3箇所の場合) : 7秒

従来 Rapid 3D 高速ヘッド : 14秒

レーザーイメージングヘッド  
測定幅 : 40mm  
検査速度 : 10,800mm<sup>2</sup>/sec 従来比 2.5倍

明暗・平面判別 (2.5D) データ  
打痕・汚れ 分離

明暗画像

平面判別 (2.5D)

Rapid 3D 小型ヘッド  
凹凸箇所のみ 3D 形状計測  
測定幅 : 4mm 検査速度 : 40mm<sup>2</sup>/sec

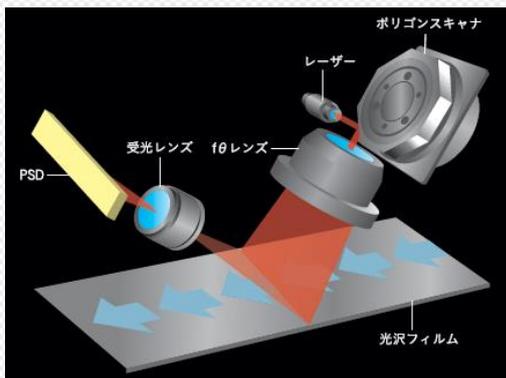
3D 形状データ 凹凸寸法計測

3D 形状

断面形状

深さ 40μm φ0.2mm

■ 計測原理



■ 金属シャフト表面キズ検査

